

# 第40期 中間報告書

2017年4月1日から2017年9月30日まで

京都発 → 世界へ

## 株主の皆さまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、当社第40期中間報告書（2017年4月1日から2017年9月30日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用環境の改善により、設備投資の持ち直しや個人消費の緩やかな回復基調が持続しております。一方、世界経済は、米国・欧州経済が堅調さを維持しておりますが、中国経済に減速の兆しが見られることに加え、米国政権の政策運営や地政学的リスクの高まりなどから、為替動向を含め依然として先行き不透明な状況が続いております。

半導体業界におきましては、微細化・積層化への大規模な設備投資が積極的に行われ、大手半導体企業の実績がますます高くなってきております。また、あらゆるものがネットにつながるIoT社会の実現に向けた技術開発や自動車の自動運転性能を高めるため、ディープラーニング（深層学習）を活用したAI（人工知能）技術の開発などにおいて、半導体メーカーが異業種間での連携を強め、各社の強みを生かし、より良いソリューションを実現するための取り組みを活発化しております。半導体の需要につきましては、サーバーやスマートフォン向けを中心としたDRAM、NAND型フラッシュメモリーが好調を維持しております。また、自動車分野において欧米中での環境規制強化によるEVシフトや電装化による半導体デバイスの搭載点数増加により、さらなる需要の拡大が期待されております。

このような状況のもと、当社グループは、スマートフォン向けカメラモジュールにはトランスファ装置を、微細化・積層化・モジュール化が進むパッケージには、コンプレッション成形技術が必須プロセスとなっており、このプロセスを用いた当社独自技術のコンプレッション装置を様々な用途で使用される半導体デバイスに対し最適ソリューションとして提案することにより、受注を獲得してまいりました。また、欧米や中国に設置いたしましたラボ機能を活用し、開発段階から評価や試作を通じてお客様のニーズを捕捉することで、強い紐帯関係を構築してまいりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は156億5百万円（前年同期比14億51百万円、10.3%増）、営業利益24億91百万円（前年同期比5億22百万円、26.6%増）、経常利益24億71百万円（前年同期比4億28百万円、21.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益16億57百万円（前年同期比48百万円、3.0%増）となり、売上高は第1四半期に引き続き第2四半期においても過去最高を記録することができました。なお、中間配当は見送りとさせていただきますが、期末配当につきましては1株当たり16円を予定しております。

引き続き株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、今後も「ものづくり企業の真価に挑む」を合言葉に、企業価値の増大を図ってまいりますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2017年12月



代表取締役社長

岡田博和

## 連結財務諸表

### ○ 四半期連結貸借対照表 (要旨)

(単位: 百万円)

科 目	当第2四半期末 2017年9月30日現在	前期末 2017年3月31日現在
<b>【 資 産 の 部 】</b>		
流 動 資 産	23,380	20,766
現金および預金	5,913	5,852
受取手形および売掛金	9,024	8,058
電子記録債権	104	67
たな卸資産	7,132	5,739
その他	1,207	1,050
固 定 資 産	15,486	15,270
有形固定資産	11,531	11,442
建物および構築物	4,372	4,514
土地	4,483	4,489
その他の	2,676	2,439
無形固定資産	626	684
投資その他の資産	3,329	3,143
資産合計	38,866	36,036
<b>【負債および純資産の部】</b>		
流 動 負 債	10,257	8,574
支払手形および買掛金	4,674	3,474
短期借入金	1,300	1,000
一年以内返済予定長期借入金	1,013	1,235
その他	3,270	2,865
固 定 負 債	1,968	2,361
長期借入金	1,167	1,626
その他	801	735
負債合計	12,225	10,936
株 主 資 本	24,308	23,052
資本剰余金	8,932	8,932
利益剰余金	462	462
自己株	14,924	13,667
その他の包括利益累計額	△ 10	△ 9
非支配株主持分	1,941	1,642
純資産合計	392	406
負債・純資産合計	26,641	25,100
	38,866	36,036

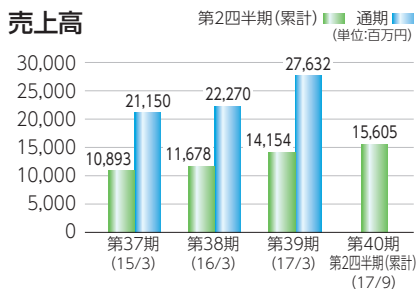
### ○ 四半期連結損益計算書 (要旨)

(単位: 百万円)

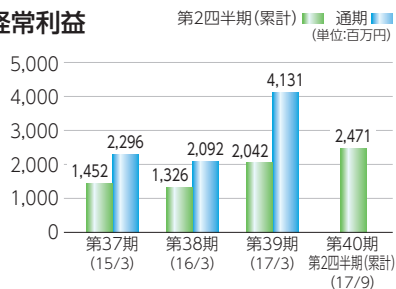
科 目	当第2四半期(累計) 2017年4月1日から 2017年9月30日まで	前第2四半期(累計) 2016年4月1日から 2016年9月30日まで
売 上 高	15,605	14,154
売 上 原 価	10,087	9,311
売 上 総 利 益	5,518	4,842
販売費および一般管理費	3,026	2,873
営 業 利 益	2,491	1,968
営 業 外 収 益	98	109
営 業 外 費 用	118	35
経 常 利 益	2,471	2,042
特 別 利 益	1	5
特 別 損 失	9	4
税金等調整前四半期純利益	2,463	2,044
法 人 税 等	791	380
四 半 期 純 利 益	1,671	1,663
非支配株主に帰属する四半期純利益	14	54
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,657	1,608

## 連結財務ハイライト

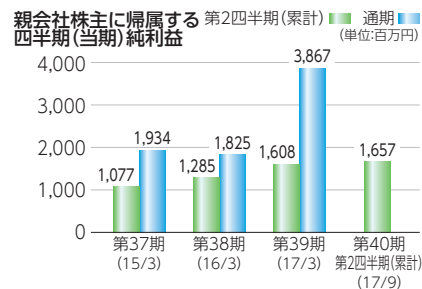
### 売上高



### 経常利益



### 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益



## 通富微电子よりアワード受賞



4月に当社の中国子会社の東和半導体設備（上海）有限公司が中国の通富微电子より「最優秀封裝設備サービス賞」を受賞いたしました。これは当社の常駐サービスと迅速な対応が高く評価されたものであり、今後ともお客様の満足度向上に努めてまいります。

## 当社ホームページをリニューアル

8月にホームページをリニューアルいたしました。内容はもちろん、より一層ご覧いただきやすくなるようデザインやレイアウトも一新いたしました。これからも当社の製品や取り組みについてタイムリーにお届けしてまいります。

## ECTC2017に出展

5月30日から4日間にわたり、アメリカで開催された「ECTC2017」に出展いたしました。

ECTCは半導体パッケージ技術に関する国際学会で、業界に当社の新技術を紹介する貴重な場となりました。当社ブースでは最新の取り組みである大型ガラスパネルモールドおよび新事業分野を中心に紹介し、多くの来場者にお越しいただくことができました。これを当社装置の受注拡大につなげるべく積極的にアプローチしてまいります。



## 会社の概要 (2017年9月30日現在)

商号	TOWA株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,932,627,777円
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎ (075) 692-0250 (代表)
従業員数	483名
ホームページ	<a href="http://www.towajapan.co.jp">http://www.towajapan.co.jp</a>
上場取引所	東京証券取引所市場第一部

役員	代表取締役社長	岡田博和
	取締役常務執行役員	浦上浩
	取締役常務執行役員	田村吉住
	取締役上席執行役員	石田耕一
	取締役常勤監査等委員	小林久芳
	社外取締役監査等委員	桑木肇
	社外取締役監査等委員	和氣大輔
	執行役員	蒲生喜代重
	執行役員	伊藤篤篤
	執行役員	高瀬慎二
	執行役員	早坂昇

## 株式の状況 (2017年9月30日現在)

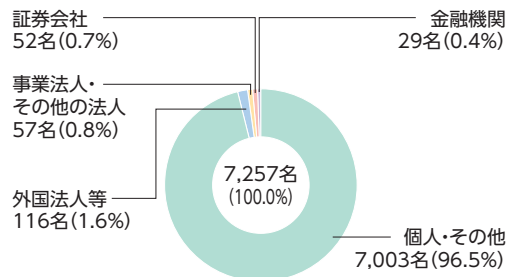
- 発行可能株式総数 80,000,000株
- 発行済株式の総数 25,021,832株
- 株主数 7,257名
- 大株主

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	5,920 千株	23.67 %
株式会社 ケイビー恒産	2,000	8.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,360	5.44
蒲生徳子	1,318	5.27
資産管理サービス信託銀行株式会社	1,022	4.09
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	980	3.92
株式会社 京都銀行	699	2.80
坂東幸子	510	2.04
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505104	391	1.57
坂東敬子	320	1.28

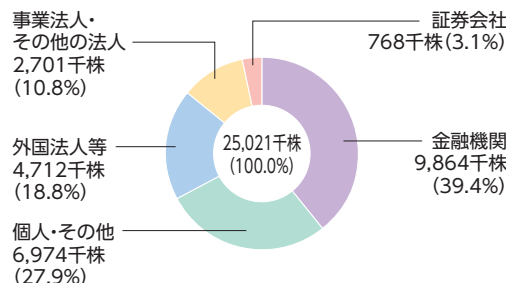
(注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(12,026株)を控除して計算しております。

### 所有者別株主数分布



### 所有者別株式数分布



## TOWAグループ (2017年9月30日現在)

### 国内

TOWA株式会社  
 本社・工場 京都東事業所  
 坂東記念研究所 九州事業所  
 東京営業所  
 株式会社バンディック  
 TOWATEC株式会社

### 海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)  
 TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)  
 TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp. (フィリピン)  
 TOWA USA Corporation (米国)  
 TOWA Europe B.V. (オランダ)  
 TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)

東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)  
 上海沙迪克軟件有限公司 (中国)  
 蘇州STK鑄造有限公司 (中国)  
 台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)  
 TOWA韓国株式会社 (韓国)  
 株式会社東進 (韓国)

## 株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年

定時株主総会 毎年6月

基準日 株主総会権利行使および期末配当 3月31日  
 中間配当 9月30日

単元株式数 100株

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号  
 みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号  
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物の郵送先及び電話お問合せ先 〒168-8507東京都杉並区泉和二丁目8番4号  
 みずほ信託銀行株式会社証券代行部  
 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行本店および全国各支店  
 みずほ銀行本店および全国各支店  
 (みずほ証券では取次のみとなります。)

公告方法 電子公告の方法により行います。但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。  
 公告掲載URL <http://www.towajapan.co.jp>